

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年1月13日(13.01.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/009884 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/025471

(22) 国際出願日: 2021年7月6日(06.07.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
PCT/JP2020/026914 2020年7月9日(09.07.2020) JP

(71) 出願人: 東邦化成株式会社(**TOHO KASEI CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 Nara (JP).

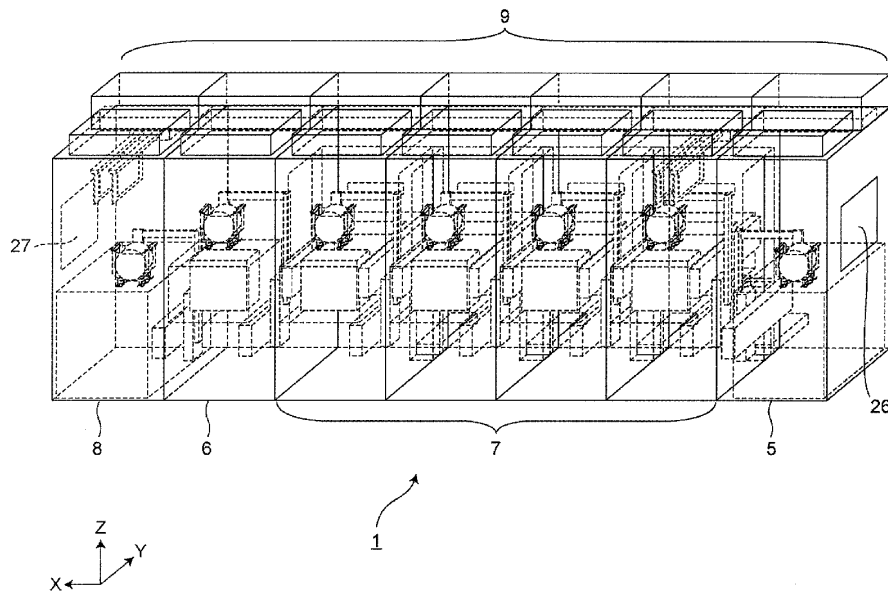
(72) 発明者: 出口 泰紀 (**DEGUCHI, Yasunori**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 東邦化成株式会社内 Nara (JP).

(74) 代理人: 山尾 憲人, 外 (**YAMAO, Norihito et al.**); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー 青山特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) **Title:** SUBSTRATE PROCESSING MODULE, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, AND SUBSTRATE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理モジュールおよび基板処理装置、並びに基板の製造方法



(57) **Abstract:** A substrate processing module (7) comprising: a first tank (34) and a second tank (32) which are arrayed in a first direction and in which a substrate (4) can be positioned; a first conveyance unit (11) that moves the substrate (4) in the first direction; and a second conveyance unit (48) that moves the substrate (4) in a second direction that intersects the first direction.

[続葉有]



WO 2022/009884 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 基板処理モジュール(7)は、第1方向に配列され、基板(4)を配置可能な第1槽(34)および第2槽(32)と、基板(4)を第1方向に移動させる第1搬送部(11)と、基板(4)を第1方向に交差する第2方向に移動させる第2搬送部(48)と、を備える。